(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 27. Mai 2004 (27.05.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/044994 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 31/0352, 31/0224

H01L 31/105,

(30) Angaben zur Priorität:

102 52 878.0

12. November 2002 (12.11.2002) DE

(61) Zusatzanmeldung zu früherer Anmeldung oder

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003739

früherem Patent:

Angemeldet am

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. November 2003 (12.11.2003)

DE

Nicht mitgeteilt (POA) 12. November 2003 (12.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

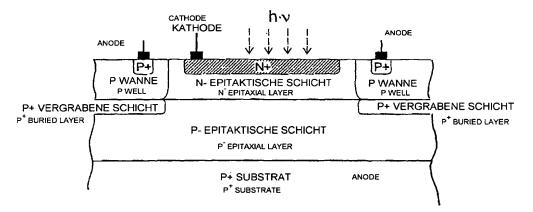
von US): X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES

AG [DE/DE]; Haarbergstrasse 67, 99097 Erfurt (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MONOLITHICALLY INTEGRATED VERTICAL PIN PHOTODIODE USED IN BICMOS TECHNOLOGY

(54) Bezeichnung: MONOLITHISCH INTEGRIERTE VERTIKALE PIN-FOTODIODE IN BICMOS-TECHNOLOGIE



(57) Abstract: The invention relates to a monolithically integrated vertical pin photodiode which is produced according to BiCMOS technology and comprises a planar surface (30) facing the light (h?) and a rear face (31), and anode connections (A1, A2) located across p areas (20, 21) on a top face of the photodiode. An i zone of the pin photodiode is formed by combining a low doped first p epitaxial layer (10, d₁₀) which has a maximum thickness of essentially 15?m and a doping concentration of less than 5*10¹⁴ cm⁻³ and is placed on a particularly high doped p substrate (10), with a low doped second n epitaxial layer (9) that borders the first layer (10) and has a doping concentration ranging substantially between 1014 cm⁻³ and 1015 cm⁻³, an n+ cathode (K) of the pin photodiode being integrated into said second layer (9). p areas (20, 21) delimit the second n epitaxial layer (9) in a latent direction while another anode-connecting area (A3) of the pin diode is provided on the rear face (31) in addition to the anode connections (A1, A2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrift eine monolithisch integrierte vertikale pin-Fotodiode, hergestellt in BiCMOS-Technologie, mit einer planaren, zum Licht (hv) gewandten Oberfläche (30) und einer Rückseite (31) und mit Anodenanschlüssen (A1, A2) über p-Gebiete (20, 21) auf einer Oberseite der Fotodiode wobei eine i-Zone der pin-Fotodiode gebildet wird durch Kombination einer niedrig dotierten, bis maximal im wesentlichen 15µm dicken ersten p'-Epitaxieschicht (10,d10) mit einer Dotierungskonzentration unter 5*1014 cm⁻³, die sich auf einem - insbesonderem hoch-dotierten - p-Substrat (10) befindet, mit einer an die erste Schicht (10) angrenzenden, niedrig dotierten zweiten n'-Epitaxieschicht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/044994 A2



- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EINBRODT, Wolfgang [DE/DE]; Hermann-Brill-Strasse 89, 99099 Erfurt (DE). ZIMMERMANN, Horst [DE/AT]; Heinrich-Collin-Strasse 29 bis 31, Stiege 3/6, A-1140 Wien (AT). FOERTSCH, Michael [AT/AT]; Linzerstrasse 192/1/7, A-1140 Wien (AT).
- (74) Anwälte: LEONHARD, Reimund usw.; Leonhard Olgemoeller Fricke, Postfach 10 09 62, 80083 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

- ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts
- (48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten Fassung: 22. Juli 2004
- (15) Informationen zur Berichtigung: siehe PCT Gazette Nr. 30/2004 vom 22. Juli 2004, Section II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(9) mit einer Dotierung in einem Bereich von im wesentlichen 10¹⁴ cm⁻³ bis 10¹⁵ cm⁻³, in welche zweite Schicht (9) eine n⁺-Kathode (K) der pin-Fotodiode eingebracht ist und wobei in einer lateralen Richtung p-Gebiete (20, 21) die zweite n-Epitaxieschicht (9) begrenzen und zusätzlich zu den Anodenanschlüssen (A1, A2) ein weiterer Anodenanschlussbereich (A3) der pin-Diode auf der Rückseite (31) vorhanden ist.